

VERSION B

A B L A A E 75

deutsche Text:
JAGE VERSION SHALL BE BINDING
Leiterplattendicke: 1.6 ±0.14mm
S: 1.6 ±0.14mm
DIN 40046
ING TO DIN 40046
Zeichnung, TE 114-94201 Version B
VING TE 114-94201 VERSION B
Einpressen
ION
foermigkeit: 40mm/m
NESS: 40mm/m
1.6mm Leiterplatte
Leiterplattenloch, siehe Tabelle 1
mm PCB
HOLE, SEE TABLE 1
t: 50.000 Stck. auf Einweg Kunststoff-Spule Ø 588mm
npapier, 3 Spulen im Karton
O PCS ON ONE-WAY PLASTIC REEL DIA.588MM
PER, 3 REELS IN BOX.
Blei) in der Leiterplatte (siehe Tabelle 1)
EAD) FOR PCB (SEE TABLE 1)
/Gold) in der Leiterplatte (siehe Tabelle 1)
EL/GOLD) FOR PCB (SEE TABLE 1)
in der Leiterplatte (siehe Tabelle 1)
FOR PCB (SEE TABLE 1)
Pin Spitze max. 30 °
PIN TIP MAX. 30 DEG.
ert nach UNS C19002
CORDING TO UNS C19002
toff-Spule PN 1-1498100-8 mit Zwischenlagenpapier
ransportkarton 973051-2
REEL PN 1-1498100-8 WITH INTERLEAVING
SHIPPING CARTON 973051-2
PN 725654-9 mit Zwischenlagenpapier PN 704973-3,
73051-2
m Nickel nach Formgebung ueber alles
EKL UPON PLATING AFTER FORMING SEQUENCE

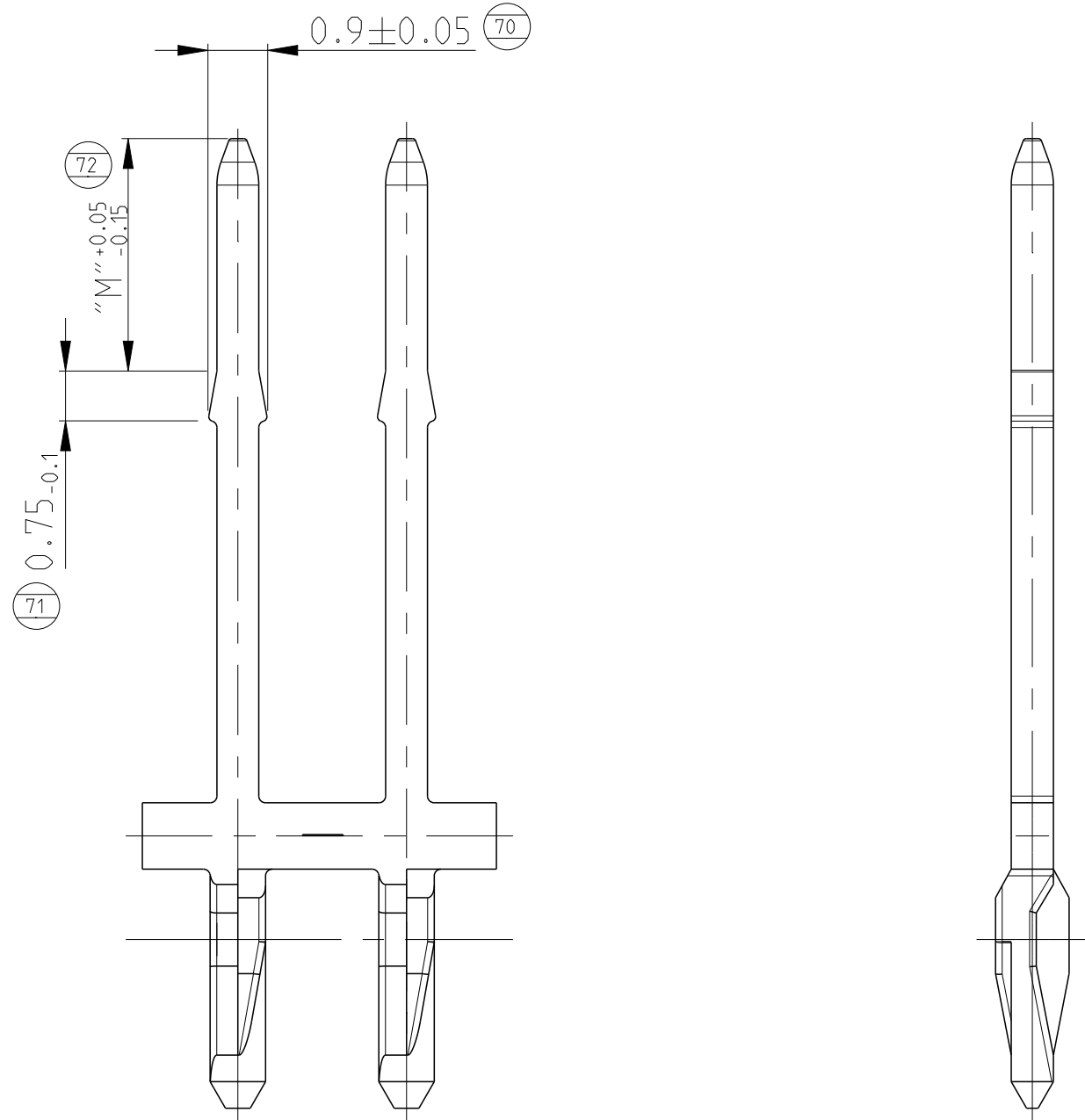
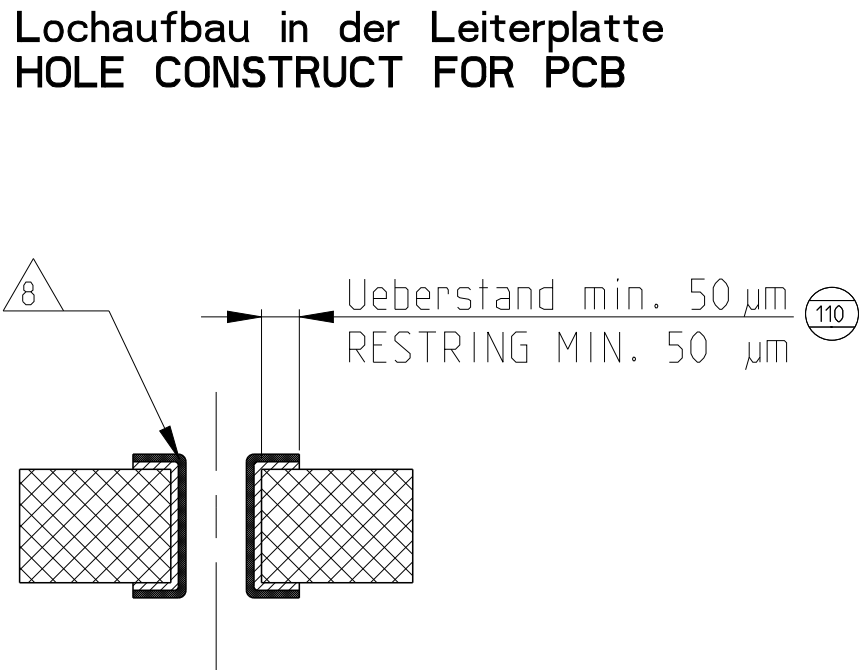


Tabelle 3
TABLE 3

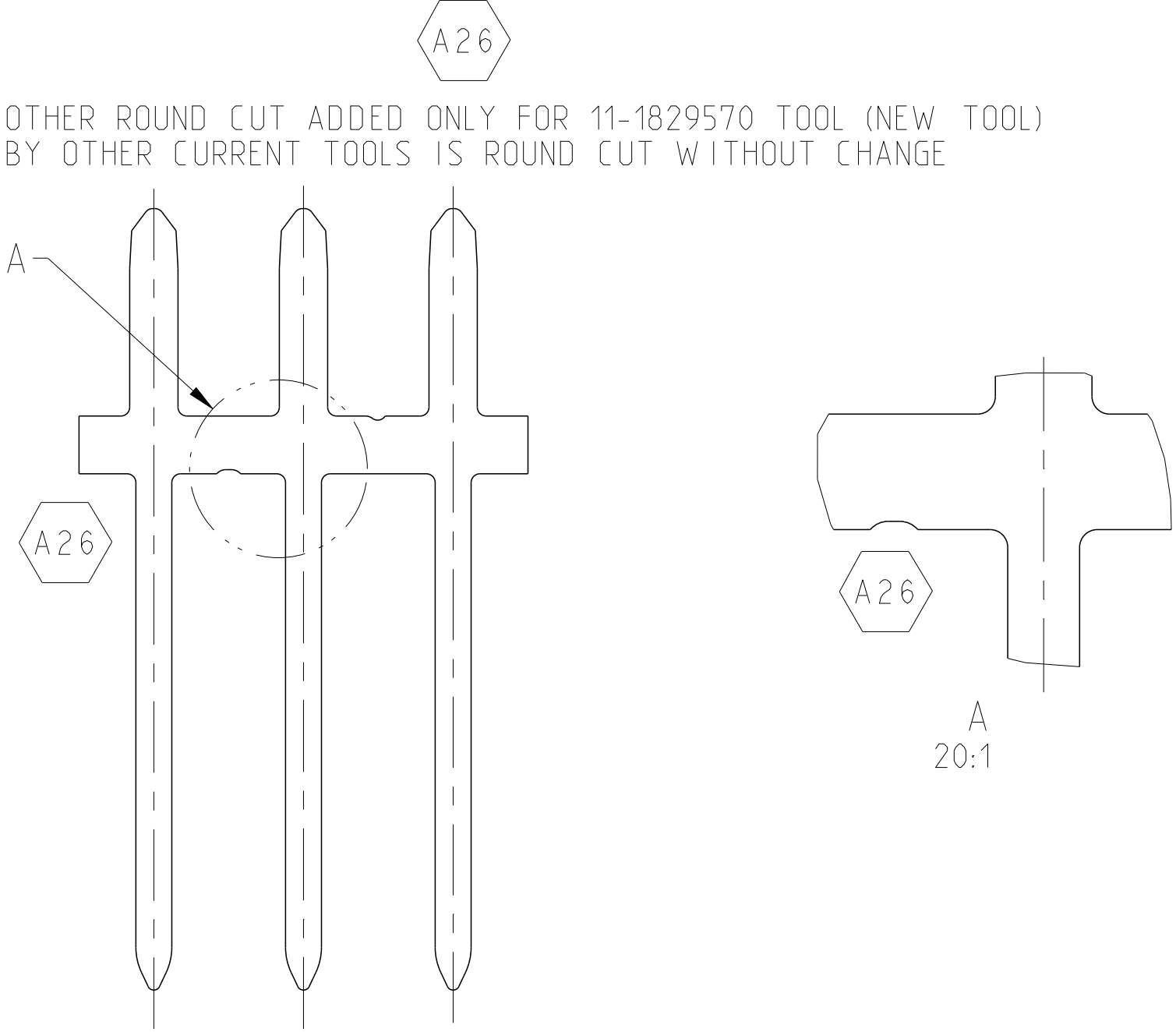
THE PN 8-963964-8 is in development status
The 8-963964-8 is not released for serial production

PN 8-963964-8 ist in dem Entwicklungsstand.
Part number 8-963964-8 ist nicht freigegeben für serienproduktion

Lochaufbau LP HOLE CONSTRUCT PCB			
Kupferschicht COPPER COATING	25-75 µm	25-75 µm	25-50 µm
Zinn/Blei Schicht TIN/LEAD COATING	4-10 µm	-	-
Zinn Schicht TIN COATING	-	-	0.5-1.5 µm
Nickel Schicht NICKEL COATING	-	max. 5 µm	-
Gold Schicht GOLD COATING	-	max. 0.2 µm	-
Bohr Ø HOLE DIA.	1.15±0.025	1.15±0.025	1.15±0.025
Plattierter Ø PLATED DIA.	$1^{+0.09}_{-0.06}$	$1^{+0.09}_{-0.06}$	$1.07^{+0.055}_{-0.045}$

Zone "I" AREA	Goldausführung: 0.8 µm bis 2 µm Au ueber Ni GOLD VERSION: 0.8 µm TO 2 µm Au OVER Ni Zinn-Ausführung: 1 µm bis 3 µm Sn TIN-VERSION: 1 µm TO 3 µm Sn SILVER-VERSION 1.5 µm to 5 µm Ag over Ni
Zone "II" AREA	Schichtdicke: 1.3 µm bis 2.2 µm Ni COAT THICKNESS: 1.3 µm TO 2.2 µm Ni FOR PN 8-963964-8 regarding note 
Zone "III" AREA	Schichtdicke: 0.8 µm bis 1.8 µm Sn ueber Ni COAT THICKNESS: 0.8 µm TO 1.8 µm Sn OVER Ni

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
GT	-	-		SEE SHEET 1	-	-	-



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN C. Beu	02DEC2002	<div><div>TE Connectivity</div></div>	
DIMENSIONS:		CHK T. Sieler	10DEC2002		
mm		APVD	-	NAME	
	0 PLC	±0.5		PRODUCT SPEC	
	1 PLC	±0.2		108-18643	
	2 PLC	±0.1		APPLICATION SPEC	
	3 PLC	±		-	
MATERIAL		4 PLC	±	SIZE	
CuNiSi R580S		ANGLES	±2°	CAGE CODE	
FINISH		FINISH	-	DRAWING NO	
-		WEIGHT	-	RESTRICTED TO	
CUSTOMER DRAWING		A 1		00779 ©=963964	
		SCALE		10:1	
		SHEET		2	
		OF		2	
		REV		A27	